

2026半导体与光学材料超精密加工技术及应用大会

自信息时代迈入智能时代，半导体与光学技术已成为推动社会进步的核心引擎。超精密加工技术作为实现高性能半导体器件、先进光学元件制造的决定性工艺，直接决定了相关产品的性能极限与产业化水平，是支撑集成电路、高端装备等战略产业发展的关键使能技术。

尤其随着半导体与光学元器件的性能边界正被不断推向极致，超精密加工技术正向着更高精度、更高表面质量方向迈进，技术壁垒日益凸显。我国在该领域的自主创新能力、核心工艺装备水平等方面仍面临严峻挑战，部分关键装备、材料依赖进口，制约了我国在半导体和光学前沿产业的自主可控与迭代速度。推动突破超精密加工领域的技术瓶颈，打破国外技术垄断，已成为业界共识与迫切需求。

在此背景下，中国粉体网将举办**2026半导体与光学材料超精密加工技术及应用大会**。本次大会旨在搭建高水平交流平台，聚焦超精密切削、研磨、抛光、刻蚀、镀膜及检测等核心工艺，分享最新研究成果，探讨技术难点，展示先进装备与应用案例，以期推动产业链上下游合作，加速技术攻关与产业化应用进程。

大会热诚欢迎国内外相关领域的专家、学者、科研人员、企业界代表及创新团队的参会交流，共同探讨技术前沿进展，分享创新成果，推进技术合作与成果转化。

时间：

2026年10月15日全天会议，10月14日全天报到

地点：

江苏苏州 白金汉爵大酒店（相城店）

主办单位：

中国粉体网

中粉研磨抛光

承办单位：

中粉会展

媒体合作：

金刚石在线

会议主题：

- 1、光学材料发展及应用现状
- 2、半导体与光学材料的超精密加工特性与机理研究
- 3、超精密加工技术发展现状
- 4、超精密激光加工在半导体与光学领域的应用
- 5、超精密镀膜技术在半导体与光学材料中的应用
- 6、高端超精密机床、抛光机、镀膜设备的技术发展与国产化进展
- 7、超精密加工用抛光盘、磨料、抛光液、夹具等耗材的研发与创新
- 8、切割、减薄、研磨、抛光设备与材料行业发展现状、应用及需求
- 9、氧化铝、碳化硅、二氧化硅及稀土抛光磨料的制备及应用现状
- 10、碳化硅、氮化硼、金刚石等超硬材料在研磨抛光领域的应用
- 11、以CMP为代表的抛光技术发展现状
- 12、化学机械抛光在半导体与光学领域的应用

- 13、抛光磨料纳米化技术发展现状
- 14、超精密加工表面的检测技术
- 15、超精密加工过程的数字化仿真与建模技术

特色活动：

大会征集参会企业相关技术合作、产品采购，工艺方案等需求进行现场采配活动，相关信息将进行展板展示，提高现场沟通交流效率！

征集内容包含但不限于以下几点：

- 1、陶瓷行业投资、融资需求
- 2、科研成果转化
- 3、产品工艺问题解决方案
- 4、原料、设备、仪器采购需求....

付款账户：

公司名称：山东中粉网信息技术有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司临沂分行

账户：37050182830100000331

会议费用：

2800元/人

包含会刊资料、茶歇、午餐、晚宴，不包含住宿费

大会赞助：

赞助详细内容请联系会务组了解

- 1、协办赞助（含展位、企业致辞，会场后方巨幅广告，视频播放，企业报告等）
- 2、晚宴赞助（含展位、晚宴大屏展示、晚宴致辞、主持人口播广告等）
- 3、其它赞助（会议礼品、环屏广告、侧屏广告，茶歇、椅背广告、胸牌广告赞助等）
- 4、展位展示（展示桌椅+展位背景墙广告）

会务组：

联系人：卢经理

联系方式：18669538053（同微信）

